

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年1-9月计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-035)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日